

芯片可靠性功能测试的要求

产品名称	芯片可靠性功能测试的要求
公司名称	深圳讯道技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋华美电子厂3层
联系电话	0755-27909791 13380331276

产品详情

那么我们常说的芯片测试，到底会测试什么呢？

三大测试

性能测试看芯片好不好

可靠性测试看芯片牢不牢

功能测试看芯片参数、指标强不强

芯片要想顺利上市应用，这三大测试缺一不可。

1、性能测试

芯片在生产制造过程中，有无数可能会引入缺陷的步骤，即使是同一批晶圆和封装成品，芯片也各有好坏，需要进行测试筛选。

2、功能测试

芯片制作出来后，为了应用不同场景，对它的各项参数、指标、功能都有一定要求，需要测试是否达标。

3、可靠性测试

芯片通过了功能与性能测试，得到了好的芯片，但是芯片会不会被冬天里讨厌的静电弄坏，在雷雨天、三伏天、风雪天能否正常工作，以及芯片能用一个月、一年还是十年等等，这些都要通过可靠性测试进行评估。

那么要想实现这些测试，我们具体要用哪些手段呢？

// 板级测试 //

主要应用于功能测试，使用PCB板+芯片搭建一个“模拟”的芯片工作环境，把芯片的接口都引出，检测芯片的功能，或者在各种严苛环境下看芯片能否正常工作。

需要应用的设备主要是仪器仪表，需要制作的主要是EVB评估板。

// CP测试 //

常应用于功能测试与性能测试中，了解芯片功能是否正常，以及筛掉芯片晶圆中的故障芯片。